

2018-2023年中国芯片行业市场发展动向调查与未来发展方向研究报告

报告大纲

观研报告网

www.chinabaogao.com

一、报告简介

观研报告网发布的《2018-2023年中国芯片行业市场发展动向调查与未来发展方向研究报告》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<http://baogao.chinabaogao.com/tongxin/297834297834.html>

报告价格：电子版: 7200元 纸介版：7200元 电子和纸介版: 7500

订购电话: 400-007-6266 010-86223221

电子邮箱: sale@chinabaogao.com

联系人: 客服

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、报告目录及图表目录

前 5G 市场步入增速放缓期，各厂商正逐步蓄力酝酿变局

领先的基带与射频分析机构 Strategy Analytics 判断，全球移动基带处理芯片的增长将一直延续到 2022 年，但自 2017 年起增速会较之前放缓，主要是因为终端出货和 LTE 投资增速下降。

2016 年基带芯片整体市场规模较 2015 年有 3.7% 的增长，超过 220 亿美元，主要来自于 LTE 基带的强劲支撑。2017 年，由于 LTE 终端出货量的增速放缓，总规模预计仅增长 0.5%，达到 221.57 亿美元。基带芯片出货量在 2016 年经历 2.1% 的下滑后，预计在 2017 年将增长 2.2% 达到 24.8 亿颗。

长期来看，Strategy Analytics 认为 LTE 网络演进到能支持更高速率（如 Cat.6 以上），且高流量消耗的应用普及会促进中低端 LTE 智能手机出货，并由此带动 LTE 基带芯片的价格降低。智能手机和其他移动终端在未来将保持平稳增长，基带芯片的年复合增速约为 2%，到 2022 年将达到 27.4 亿颗的出货量，对应 237 亿美金的销售额。

图：4G 基带芯片出货占比迅速提升

根据 Strategy Analytics，过去几年内，2G 和 3G 基带芯片出货占比从近 40% 和 60% 下降到 2016 年的双双 20% 左右，而 4G 基带芯片几乎从零一路提升至 60% 的占比，绝对数目也超过了 14 亿颗。

图：总市场规模已趋于平稳，4G 基带强势挤占份额

市场规模上看，2014 年全球超过 220 亿美金高点后，一直在此位置盘整，显示市场区域饱和，增量空间有限。2016 年，虽然 2G 和 3G 在出货量上尚占据 40% 左右份额，但整体份额已经从近 100% 跌落到 20% 以内。4G 基带芯片是支撑总规模的主要来源，而且日益收缩的 2/3G 网络将使得 LTE 进一步强化份额挤占。

由于发达国家的移动终端市场已经饱和，2016 年全球出货量约 22.53 亿部，已经比前一年下降约 5.4%，预计 2017 年出货量将有 5.3% 左右的回升。到 2022 年移动终端年出货量预计将达到 27 亿部，意味着这些年的复合增速在 3.1%，较此前的预计更为保守，反应了智能手机增速放缓程度超出此前判断，且 2G 终端的下滑也在加快。

未来增量市场空间已经不大，更多的是 4G 终端对 2G 和 3G 的份额挤占。我们认为，到 2020 年 4G 总体占比有望超过 90%。

图：全球基带芯片市场规模和主要厂商份额

出货量上看，2016 年高通、联发科、展讯、三星、Intel 和海思位列全球手机基带芯片市场前六位，占比分别为 33.7%、29.7%、23.4%、4.7%、3%和 2.1%，但并不意味着市场份额越大，技术实力越强。

目前基带技术领先的三家厂商分别是高通、Intel、三星和海思。联发科和展讯主要占据中低端市场，技术上滞后 1 到 3 年。各厂商也不完全是竞争关系，Intel 作为展讯的第二大股东拥有其 20% 的股份。

联发科目前综合水平强于展讯，但缺乏展讯本土优势地位，展讯更易获得国内市场支持和来自 Intel 的技术支持，即使在 5G 初始阶段技术相对落后，也可借助 Intel 的芯片开拓市场。长期看，展讯发展的后劲更足。而联发科在 4G 并未占据高端市场，盈利水平受限，而 5G 又需要海量的资金投入，我们认为后续联发科将共同与展讯处于中游竞争地位。

联芯受益于国内的 TDS 产业，其 TDS 芯片具备相当的实力，但中移动正逐步裁撤 TDS 网络，其 4G 的发展没有及时跟进，目前看弱于展讯和联发科。不过有国内产业政策，资金和市场的多方支撑，5G 大概率将取得空前突破。

图：厂商技术实力梯队

高通一直是手机基带芯片市场的领导者，不但在各种规格上引领 LTE 设计芯片，更可能推出第一款 5G 基带芯片。去年其手机基带芯片出货量仍增长了 8%，主要得益于旗下骁龙芯片的强劲表现。但强大的专利墙也难以抵挡各方竞争对手的压力，高通 LTE 手机基带芯片的份额在快速，从 2015 年的 65% 下滑到了 2016 年的 52%。

去年 Intel 在苹果的 iPhone7 和 7 plus 挤占了高通的部分基带芯片份额，其在高端产品地位开始受到撼动。我们认为，英特尔将会在 2017 年苹果推出的新品中获得更高的手机基带芯片份额，这将进一步压缩高通的出货量。

中国报告网发布的报告书内容严谨、数据翔实，更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展动向、市场前景、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。它是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局，规避经营和投资风险，制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

【报告目录】

第一部分行业环境透视

第一章芯片行业薪酬构成细项解析

第一节定义

第二节基本工资

第三节补贴

第四节变动收入

第五节福利

第二章芯片行业薪酬环境分析

第一节宏观经济概况

一、宏观经济指数

二、人才市场情况

三、重点城市职工工资情况分布

第二节人工成本报告

一、人工成本数据

二、劳动报酬数据

第三节薪资政策报告

一、调薪政策

二、调薪幅度

第四节管理人员/专业技术人员/生产服务技能人员薪酬水平报表

一、管理人员薪酬水平

二、专业技术人员薪酬水平

三、生产服务技能人员薪酬水平

四、市场薪酬结构

第二部分行业运行现状

第三章芯片行业薪酬管理方法论

第一节薪酬管理五个原则

一、依据战略

二、公平原则

三、竞争原则

四、激励原则

五、经济原则

第二节薪酬管理现状快速诊断分析之五大维度

一、内部公平性

二、激励性

三、外部竞争性

四、经济性

五、薪酬策略

第三节4D构建模型

一、职位差异

二、市场差异

三、能力差异

四、绩效差异

第四节4E构建模型

一、内部公平性

二、外部公平性

三、个体公平性

四、组织公平性

第四章芯片行业薪酬管理诊断指标展示(一个定性，四个定量)

第一节定性分析

第二节定量分析

一、内部公平性

1、部门人均工资和部门总收入占比

2、内部绝对和相对薪酬差距分析

3、不同等级员工的薪酬内部竞争力

4、不同职类员工的薪酬内部竞争力

二、外部竞争性

1、等级薪酬外部竞争力

2、职类薪酬外部竞争力

3、岗位薪酬外部竞争力

4、补充福利外部竞争力

三、激励性

1、不同职类的薪酬构成

2、不同层级的薪酬构成

3、人力资本投资回报

4、主动离职率

四、经济性

1、薪酬福利占营业收入的比例

2、薪酬福利占营业支出的比例

3、奖金占薪酬总额的比例

4、薪酬福利总额增长率

第五章芯片行业薪酬人力资源管理现状

第一节付薪理念

第二节企业关键核心层级、部门和岗位梳理

第三节现阶段各层级、职类薪酬定位

第四节等级薪酬制度分析

第五节薪酬增长分析

第六节福利项目实施情况分析

第七节员工离职率分析

第八节其他人力资源管理问题分析

第六章芯片行业等级薪酬分析

第一节基本薪酬等级回归分析

第二节固定薪酬等级回归分析

第三节总现金等级回归分析

第四节整体薪酬等级回归分析

第三部分竞争格局分析

第七章芯片行业薪酬内部公平性分析

第一节关键核心层级分析

第二节关键核心部门分析

第三节关键核心岗位分析

第四节各层级薪酬定位

第五节部门人均工资和总收入占比

第六节内部薪酬差距分析

第七节等级薪酬内部分析

第八节职类薪酬内部分析

第八章芯片行业薪酬外部竞争性分析

第一节等级薪酬外部竞争性分析

第二节等级薪酬散点分析

第三节职类薪酬外部竞争性分析

第四节岗位薪酬外部竞争性分析

第五节岗位薪酬偏离度统计分析

第六节补充福利竞争性分析

第七节薪酬调整建议

第九章芯片行业薪酬激励性

第一节职类薪酬构成

第二节层级薪酬构成

第三节人力资本投资回报

第四节主动离职率

第十章芯片行业薪酬经济性分析

第一节薪酬总额占营业收入比例

第二节薪酬总额占营业支出比例

第三节奖金占薪酬总额比例

第四节薪酬福利总额增长率

第十一章2015-2017年芯片行业各区域企业薪酬发展分析

第一节华北地区

一、经济发展现状

二、行业分布情况

三、企业薪酬现状

第二节华南地区

一、经济发展现状

二、行业分布情况

三、企业薪酬现状

第三节华中地区

一、经济发展现状

二、行业分布情况

三、企业薪酬现状

第四节东北地区

一、经济发展现状

二、行业分布情况

三、企业薪酬现状

第五节华东地区

一、经济发展现状

二、行业分布情况

三、企业薪酬现状

第六节西南地区

一、经济发展现状

二、行业分布情况

三、企业薪酬现状

第七节西北地区

一、经济发展现状

二、行业分布情况

三、企业薪酬现状

第十二章芯片行业重点企业薪酬管理现状分析

第一节英特尔(中国)有限公司

(1) 企业概况

(2) 主营业务情况分析

(3) 公司运营情况分析

(4) 公司优劣势分析

第二节三星电子株式会社

(1) 企业概况

(2) 主营业务情况分析

(3) 公司运营情况分析

(4) 公司优劣势分析

第三节高通无线通信技术(中国)有限公司

(1) 企业概况

(2) 主营业务情况分析

(3) 公司运营情况分析

(4) 公司优劣势分析

第四节德州仪器半导体技术(上海)有限公司

第四部分发展战略分析

第十三章芯片行业企业薪酬策略分析

第一节薪酬策略分类

- 一、薪酬水平策略
- 二、薪酬激励策略
- 三、薪酬结构策略
- 四、薪酬组合策略
- 五、薪酬总额策略
- 六、薪酬架构策略
- 七、薪酬差别策略
- 八、薪酬增长策略
- 九、薪酬支付策略
- 十、不同类型人员的薪酬支付策略

第二节策略管理

- 一、明确公司的薪酬策略
- 二、向员工讲明公司的涨薪理念

第十四章2018-2023芯片行业企业薪酬发展建议分析

第一节芯片行业企业薪酬研究结论及建议

第二节芯片行业企业薪酬研究结论及建议

第三节芯片行业企业薪酬竞争策略总结及建议

图表目录

图表：芯片薪酬行业分类表

图表：2011-2017年芯片薪酬行业总产值及占GDP比重（单位：亿元，%）

图表：我国统计上大中小微型企业划分标准（工业类）（单位：人，万元）

图表：中国企业的市场主体分类

图表：中国不同所有制性质企业的划分图表：芯片薪酬行业所处产业链示意图

图表：中国芯片薪酬主要消费群体特点分析（元）

图表：2015-2017年芯片行业管理层工资分布情况

图表：2015-2017年芯片行业普通员工工资分析

图表：2015-2017年芯片行业管理成本分析

图表：2015-2017年芯片行业人力资源分布图分析

图表：2015-2017年芯片行业中层员工工资分析

图表：2015-2017年芯片行业工资增长变化情况

图表：2015-2017年芯片行业管理层变化情况

图表：2015-2017年芯片行业销售费用变化情况

图表：2015-2017年芯片行业销售费用占比变化情况

图表：2018-2023年芯片行业管理成本预测

图表：2018-2023年中国芯片行业工资收入预测

图表：芯片行业规划品牌目标

图表：芯片行业新产品份额规划

更多图表详见正文（GSLWK）

特别说明：中国报告网所发行报告书中的信息和数据部分会随时间变化补充更新，报告发行年份对报告质量不会有任何影响，并有助于降低企事业单位投资风险。

详细请访问：<http://baogao.chinabaogao.com/tongxin/297834297834.html>